

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 7 部門第 2 区分
 【発行日】平成 17 年 5 月 19 日 (2005.5.19)

【公開番号】特開 2003-8167 (P2003-8167A)
 【公開日】平成 15 年 1 月 10 日 (2003.1.10)
 【出願番号】特願 2001-183185 (P2001-183185)
 【国際特許分類第 7 版】

H 0 5 K 1/18

H 0 5 K 3/32

【F I】

H 0 5 K 1/18 R

H 0 5 K 1/18 P

H 0 5 K 3/32 B

【手続補正書】

【提出日】平成 16 年 7 月 6 日 (2004.7.6)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

回路形成面に金属にて形成した回路パターンを有する第 1 基材内へ電子部品を埋設し、埋設された上記電子部品の電極と上記回路パターンとの電氣的接続を図る導通部を上記回路形成面に形成する、
 ことを特徴とする電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項 2】

上記第 1 基材内への上記電子部品の埋設後、上記導通部の形成前に、埋設された上記電子部品の上記電極を上記回路形成面に露出させ、該露出後に上記導通部を形成する、請求項 1 記載の電子部品実装済部品の製造方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 記載の電子部品実装済部品の製造方法を用いて電子部品実装済部品の製造した後、

上記第 1 基材の厚み方向から第 2 基材及び第 3 基材にて上記第 1 基材のラミネート処理を行なうことを特徴とする電子部品実装済完成品の製造方法。

【請求項 4】

請求項 1 から 3 のいずれかに記載の、電子部品実装済完成品の製造方法にて製造されたことを特徴とする電子部品実装済完成品。

【請求項 5】

非接触 IC カードを構成するため、上記回路パターンは、無線にて情報の送受信を行なうアンテナコイル形状にてなる、請求項 4 記載の電子部品実装済完成品。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために本発明は以下のように構成する。

本発明の第 1 態様における、電子部品実装済部品の製造方法は、回路形成面に金属にて形成した回路パターンを有する第 1 基材内へ電子部品を埋設し、

埋設された上記電子部品の電極と上記回路パターンとの電氣的接続を図る導通部を上記回路形成面に形成する、

ことを特徴とする。